

(上接C6版)

(2)与行业平均滚动市盈率比较
本次发行价格52.28元/股对应发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为25.06倍(2023年10月至2024年9月),低于中证指数有限公司2025年3月6日(T-3日)发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均滚动市盈率29.24倍。

Table with 6 columns: 市盈率类别, 最新值, 最近一个月平均值, 最近三个月平均值, 最近半年平均值, 最近一年平均值. Rows include 静态市盈率, 滚动市盈率.

注:数据来源为中证指数有限公司
近一年以来,专用设备制造业(C35)行业平均市盈率水平较为平稳。本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍,低于中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均静态市盈率29.67倍,亦低于中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均滚动市盈率29.24倍。

2、与可比上市公司估值水平比较情况
根据《招股说明书》,公司主要产品为探针台产品,A股目前暂无其他主营业务为探针台产品的上市公司。公司的竞争对手主要为日本的东京电子、东京精密以及中国台湾地区的惠特科技、旺矽科技。考虑到目前境内没有主营业务为探针台设备的已上市企业,且境外上市公司与国内上市公司在会计准则、估值水平等方面存在差异,故选择在A股上市的同为半导体测试设备行业的华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、联动科技(301369.SZ)及金海通(603061.SH)作为可比公司。上述可比公司的产品包括测试机、分选机等,与公司的产品同属于半导体测试设备,与公司存在共同客户且面临相似的行业竞争环境,在经营模式、收入规模及未来发展等方面与公司具备相似性,将其作为可比公司具有合理性。同行业可比公司市盈率水平情况如下:

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, 2025年3月6日前20个交易日日均价(前复权,含当日), 2025年3月6日收盘价(元/股), 2023年EPS(扣非前), 2023年EPS(扣非后), 2023年扣非前, 2023年扣非后, 2023年静态市盈率(倍), 2023年滚动市盈率(倍). Rows include 688200.SH, 300604.SZ, 301369.SZ, 603061.SH, 算术平均值, 矽电股份.

注1:数据来源Wind;计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注2:可比公司2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益后/后归母净利润+2025年3月6日总股本,2023年扣非前/后静态市盈率=2025年3月6日前20个交易日日均价(含当日)与3月6日收盘价之比。
注3:扣非前/后滚动市盈率=2025年3月6日前20个交易日日均价(含当日)与3月6日收盘价之比。
注4:长川科技、联动科技2023年扣非前后静态市盈率较可比公司显著异常,计算可比公司2023年静态市盈率算术平均值时将其剔除;联动科技扣非前后滚动市盈率显著异常,计算可比公司滚动市盈率算术平均值时将其剔除。

(1)与可比公司静态市盈率比较
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为26.23倍,低于扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均滚动市盈率29.24倍(截止2025年3月6日)。

(2)与可比公司滚动市盈率比较
本次发行价格对应的发行人近四个季度(2023年10月至2024年9月)扣除非经常性损益前后归母净利润摊薄后滚动市盈率为25.06倍,低于扣除非经常性损益前后归母净利润的平均滚动市盈率29.24倍(截止2025年3月6日)。

3、发行人与可比公司的比较
发行人与可比公司在市场地位和技术实力方面的比较情况如下表所示:

Table with 3 columns: 公司名称, 市场地位, 技术实力. Rows include 华峰测控(688200.SH), 长川科技(300604.SZ), 联动科技(301369.SZ), 金海通(603061.SH), 发行人.

注:市场地位、技术实力资料来源于长川科技2023年半年报、华峰测控年度报告及招股说明书、联动科技招股说明书、金海通招股说明书。

由上表可见,发行人立足探针台测试技术,持续贴近客户需求,面向高端市场和前沿需求推出新产品,保障公司主要产品的市场竞争力。目前发行人已成为境内最大的探针台研发、生产、销售企业,是境内首家能够研发、批量生产并交付12英寸探针台的企业。

发行人与可比公司主要业绩指标对比情况如下:

Table with 5 columns: 公司名称, 年度, 营业收入(万元), 毛利率, 净利润(万元). Rows include 华峰测控, 长川科技, 联动科技, 金海通, 本公司.

注:数据来源:可比公司招股说明书、定期报告。

近年来,发行人业绩较为稳定,凭借产品技术优势迅速打开市场,已成为国内具有代表性的探针台设备制造商,直接与境外厂商形成全面竞争,在国产替代政策的背景下,积极拓展市场,积累了优质的客户资源,业务具有成长性,为发行人近年来的业绩奠定基础。

4、发行人的竞争优势
(1)较为雄厚的研发实力与较为强大的持续创新能力
发行人自成立以来就扎根探针台测试技术领域,经过多年研发、技术创新,积累了较多行业经验、知识产权,形成了一支较为雄厚的研发团队,具有较为强大的持续创新能力,并以此

在业内形成了一定的技术优势。

发行人的核心研发人员拥有多年半导体、探针台测试技术领域的研发和管理经验。发行人研发技术人员不仅具备集成电路设计、信息处理、精密机械结构设计、电路优化设计、软件设计、精密光学等复合知识背景,还拥有多年的行业实践经验,对下游应用市场产品特性理解深刻。发行人已掌握高精度快响应大行程精密步进技术、定位精度协同控制、探针卡自动对针技术、晶圆自动上下片技术、基于智能算法的机器视觉、电磁兼容性设计技术等多项探针台测试核心技术。截至2024年6月30日,发行人已取得境内外授权专利246项、软件著作权79项。

发行人能够及时理解、挖掘客户的需求并通过研发将探针台测试技术快速转换为满足需求的半导体专用设备。能够快速将市场需求产品化并交付,是发行人具备较强研发竞争力的重要体现,也是客户选择供应商的重要标准之一。面对下游客户对探针台等半导体设备需求多样的特点,发行人通过客户需求响应研发与主动研发相结合的方式,将前沿的先进技术运用于发行人产品开发中,快速研发并交付满足客户需求的产品设备。

发行人建立了以研发中心为核心,并与生产部门、销售部门、技术服务部等其他部门协作的技术开发体系,并在长期生产经营、项目开发中积累了丰富的经验、专利及管理制度、标准作业程序文件。

(2)优质的客户资源
凭借优秀的技术实力、严格的质量控制,积极的前售前售后服务,发行人目前已成为多家境内一流半导体厂商的供应商,包括但不限于:士兰微、比亚迪半导体、燕微、华天科技、三安光电、华润微、光迅科技、歌尔、兆驰股份等。半导体厂商的供应商认证程序非常严格,认证周期较长,对技术和服务能力、产品稳定性、可靠性和一致性等多个方面均有较高要求,新进入者获得认证的难度较大。前述半导体厂商均居于境内半导体行业前列,拥有较强的规模优势、技术优势,成为其供应商有利于发行人长久稳定发展。

发行人研发、技术人员为客户提供专业高效的售前服务,增强客户粘性。探针台具有一定的定制、非标准化特点,在客户开发新产品、规划生产线的前期就需要发行人直接与客户沟通以获取需求信息,通常需经过多轮沟通才能研发、设计出满足客户需求的探针台设备。发行人已经建立的客户合作网络,为发行人持续满足客户最新设备需求,提供有竞争力的产品奠定基础。

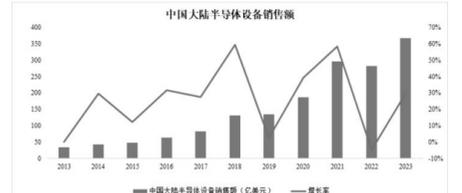
(3)地缘优势及快速响应的售后服务
发行人的竞争对手主要是日本的东京电子、东京精密和惠特科技、旺矽科技等,相对于这些境外竞争对手,发行人具有地缘优势,更加贴近中国大陆半导体生产市场。发行人的销售人员除拥有较强的市场营销能力,还掌握丰富的半导体测试技术理论知识,熟悉行业发展状况。经过多年的磨练与积累,发行人已逐步建立了一支人员稳定、技术基础扎实、拥有丰富行业应用经验,且同时具备市场经营理念的复合型人才队伍。

我国已连续多年成为全球最大的半导体消费市场,消费重心转移带动了产能重心向我国转移,半导体设备具有较为明显的国产化需求及趋势。据SEMI统计,2021年至2022年全球预计建设投产的29座半导体晶圆厂中有8座位于中国大陆,占比达27.59%。据SEMI预测,预计2022年至2026年间全球将有94座200毫米和300毫米晶圆厂上线,其中30个位于中国大陆,占比达31.91%。发行人一直秉承快速响应的售后服务。在设备行业,发行人客户在使用设备时,难免会发生一些故障,这些故障的及时排查、解决可以使客户顺利完成生产任务。同时,随着客户产品的更新换代,也需要发行人的设备做出相关升级调整。针对以上需求,发行人以客户为中心,提供7*24小时及时高效的技术支持和服务,培养了一支具备优良专业技能的售后团队,并根据部分客户需求,提供驻厂服务,实时解决产品售后问题,更新需求。所以,更加贴近中国大陆半导体生产企业并具有优质快速响应的售后服务是发行人的一大竞争优势。

(4)完善的供应链
半导体设备属于高精度的自动化装备,研发和生产均需使用大量的高精度元器件,对产品机械结构的精度和材质要求高。经过多年的沉淀,发行人与国内外供应商建立了较为稳定的合作关系,培育与建设成了较为完善的原材料、部件供应体系,有利于保证发行人产品部件来源的稳定性及可靠性。

(三)发行人所处行业发展空间和竞争格局
1、我国半导体设备市场规模快速增长为全球最大市场,具有广阔的国产替代空间
近年来,受益于强有力的国家战略支持,密集的资本和人才投入,以及全球半导体产业第三次转移,国内半导体专用设备企业迎来重大发展机遇。据SEMI统计,国内大陆半导体设备销售规模已由2013年的33.70亿美元增长至2023年的366亿美元,年复合增长率26.94%,除2022年度发生下滑外其余年度均呈现增长态势,且增速高于全球半导体设备销售规模增速。同时,中国大陆半导体设备市场规模在全球市场中的

占比也逐年攀升,由2013年的10.60%增长至2023年的34.44%。

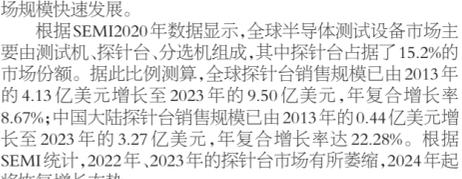


数据来源:SEMI

现阶段我国半导体设备主要依赖进口,而且在中高端及核心设备领域,国外知名半导体设备企业占据了较大份额。根据安信证券研究所统计,2022年我国前道半导体设备市场占有率为16.49%,后道半导体设备市场占有率为13.2%,仍有较大提升空间。

2、探针台是半导体测试领域三大核心设备之一,市场规模持续增长
半导体测试设备的运用贯穿整个半导体制造过程,在半导体产业链中起着成本控制和保证品质的关键作用。探针台系半导体三大核心测试设备之一,探针台市场发展前景与半导体制造工艺的进步密切相关,半导体产量提升密切相关。采用先进工艺制造的芯片具备更复杂、更紧凑的结构特征,芯片测试过程要求探针台具备更高的操控精度;而应用场景的拓宽以及芯片结构尺寸的缩小又引发芯片产量以及测试需求上升,因此业界对探针台设备的需求量及性能要求持续提升,探针台市场规模快速提升。

根据SEMI2020年数据显示,全球半导体测试设备市场主要由测试机、探针台、分选机组成,其中探针台占据了15.2%的市场份额。据此比例测算,全球探针台销售规模已由2013年的4.13亿美元增长至2023年的9.50亿美元,年复合增长率8.67%;中国大陆探针台销售规模已由2013年的0.44亿美元增长至2023年的3.27亿美元,年复合增长率达22.28%。根据SEMI统计,2022年、2023年的探针台市场有所萎缩,2024年起将恢复增长态势。



数据来源:SEMI

3、行业竞争格局
探针台设备行业集中度较高,目前主要由国外厂商主导,行业呈现高度垄断的竞争格局。根据SEMI统计数据,从全球市场上看,东京精密、东京电子两家企业占据全球约七成的市场份额,其次为惠特科技、旺矽科技等。从中国大陆市场上看,2019年东京电子、东京精密、惠特科技、旺矽科技占据了74%的市场份额,中国大陆市场进口替代空间巨大。应用于12英寸存储芯片、逻辑芯片、模拟芯片和射频芯片领域的高端探针台市场由日本厂商东京精密和东京电子垄断,是影响我国芯片产业链安全的卡脖子领域。



数据来源:SEMI、CSA Research

发行人是境内规模最大的探针台制造企业,根据SEMI和CSA Research统计,2019年中国大陆探针台设备市场中,矽电股份占据13%的市场份额,市场排名第四名,是排名第一的境内厂商。

同时,发行人也是中国大陆首家实现产业化应用的12英寸晶圆探针台设备厂商,已在多个半导体产品领域打破海外厂商垄断,发行人产品已应用于燕微、士兰微、比亚迪半导体、华天科技、三安光电、光迅科技、歌尔微等国内领先的晶圆制造、封装测试、光电芯片及传感器厂商。

(下转C8版)

(上接C6版)

本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股说明书》。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规、法规做出的自愿承诺。

6、发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、公司基本面、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为52.28元/股。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

本次发行价格52.28元/股对应的市盈率为:

- (1)19.68倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)18.34倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
(3)26.23倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
(4)24.45倍(每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

7、本次发行价格为52.28元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)与行业平均市盈率比较
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“专用设备制造业(C35)”。

①与行业平均静态市盈率比较
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍,低于中证指数有限公司2025年3月6日(T-3日)发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均静态市盈率29.67倍。

②与行业平均滚动市盈率比较
本次发行价格52.28元/股对应发行人扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为25.06倍(2023年10月至2024年9月),低于中证指数有限公司2025年3月6日(T-3日)发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均滚动市盈率29.24倍。

③发行人所属行业市盈率变化态势

截至2025年3月6日(T-3日),专用设备制造业(C35)各阶段平均静态市盈率和滚动市盈率如下:

Table with 6 columns: 市盈率类别, 最新值, 最近一个月平均值, 最近三个月平均值, 最近半年平均值, 最近一年平均值. Rows include 静态市盈率, 滚动市盈率.

注:数据来源为中证指数有限公司
近一年以来,专用设备制造业(C35)行业平均市盈率水平较为平稳。本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍,低于中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均静态市盈率29.67倍,亦低于中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月平均滚动市盈率29.24倍。

(2)与可比公司的比较情况
根据《招股说明书》,公司的竞争对手主要为日本的东京电子、东京精密以及惠特科技、旺矽科技。考虑到目前境内没有主营业务为探针台设备的已上市企业,且境外上市公司与国内上市公司在会计准则、估值水平等方面的差异,故选择在A股上市的同为半导体测试设备行业的华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、联动科技(301369.SZ)及金海通(603061.SH)作为可比公司。同行业可比公司市盈率水平情况如下:

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, 2025年3月6日前20个交易日日均价(前复权,含当日), 2025年3月6日收盘价(元/股), 2023年EPS(扣非前), 2023年EPS(扣非后), 2023年扣非前, 2023年扣非后, 2023年静态市盈率(倍), 2023年滚动市盈率(倍). Rows include 688200.SH, 300604.SZ, 301369.SZ, 603061.SH, 算术平均值, 矽电股份.

注1:数据来源Wind;计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注2:可比公司2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益后/后归母净利润+2025年3月6日总股本,2023年扣非前/后静态市盈率=2025年3月6日前20个交易日日均价(含当日)与3月6日收盘价之比。
注3:扣非前/后滚动市盈率=2025年3月6日前20个交易日日均价(含当日)与3月6日收盘价之比。
注4:长川科技、联动科技2023年扣非前后静态市盈率较可比公司显著异常,计算可比公司2023年静态市盈率算术平均值时将其剔除;联动科技扣非前后滚动市盈率显著异常,计算可比公司滚动市盈率算术平均值时将其剔除。

注4:长川科技、联动科技2023年扣非前后静态市盈率较可比公司显著异常,计算可比公司2023年静态市盈率算术平均值时将其剔除;联动科技扣非前后滚动市盈率显著异常,计算可比公司滚动市盈率算术平均值时将其剔除。

①与可比公司静态市盈率比较
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍,低于扣除非经常性损益后归母净利润的2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍(截止2025年3月6日,T-3日)。

B、与可比公司滚动市盈率比较
本次发行价格对应的发行人近四个季度(2023年10月至2024年9月)扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率为25.06倍,低于扣除非经常性损益和扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润的平均滚动市盈率72.67倍(截止2025年3月6日,T-3日)。

发行人本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后静态市盈率,低于扣除非经常性损益和扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润平均静态市盈率;本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后滚动市盈率,亦低于扣除非经常性损益和扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润平均滚动市盈率。

综上,公司考虑自身主营业务、盈利能力、成长性等状况,并结合同行业可比公司业务情况及相关财务数据,在参考了行业市盈率水平和同行业公司平均市盈率水平后确定本次发行价格,发行市盈率低于行业市盈率水平,低于同行业可比上市公司平均市盈率水平,发行定价具备合理性,定价原则亦具备谨慎性,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。充分理解《招股说明书》中披露的相关风险因素,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

8、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注新股投资蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、按本次发行价格52.28元/股和1,043,181.9万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额约为54,537.55万元,扣除预计发行费用约8,184.68万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为46,352.87万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股

申购,上述账户参与申购的,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首个有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经深交所批准,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与网上申购的投资者。

12、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施:
(1)网上投资者申购数量不足本次公开发行股票数量的;
(2)网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%;
(3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(4)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)第五十六条和《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。投资者已缴纳认购款,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注销的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

13、发行人、保荐人(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

14、本投资风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:矽电半导体设备(深圳)股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
2025年3月10日